

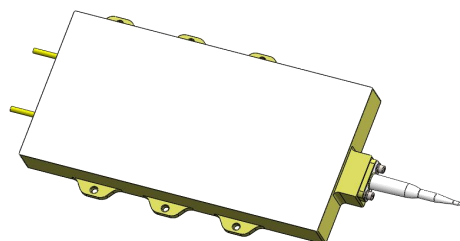
PN:793DA500220-II

应用领域Applications:

- 光纤激光器泵浦 Fiber laser pumping

版本变更说明:

- Rev D1: Draft---250303
- Rev D2: Add typical power and update wavelength---250430



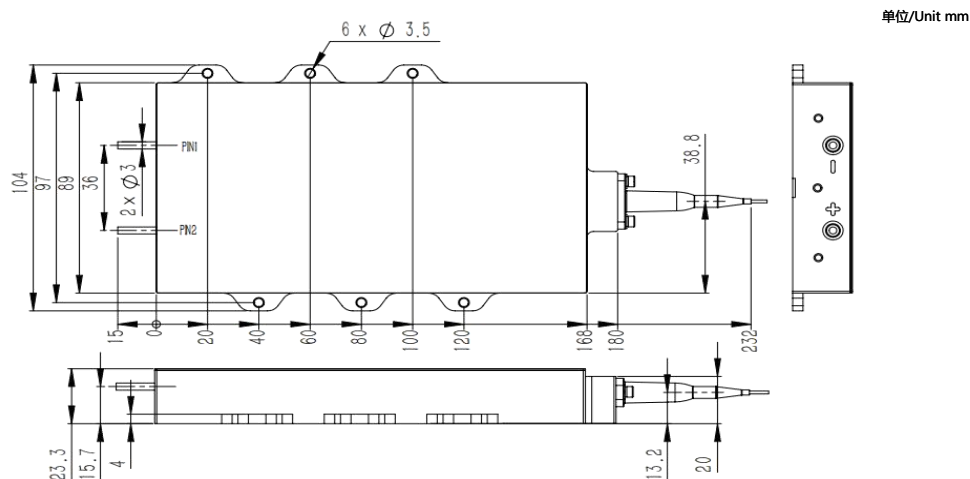
光学参数 ¹ /Optical Parameters ¹	Unit	Minimum	Typical	Maximum
输出功率/Output Power	W	500	550	
中心波长 ² /Center Wavelength ² @22A	nm	793.5	796.5	799.5
光谱宽度/Spectral Width(FWHM)	nm		6	
95%出光NA/95% Power Within NA	NA		0.19	
防反射波段/Back Reflection Isolation Range	nm	1850		2150
防反射隔离度/Back Reflection Isolation	dB	30		

光纤参数/Fiber Parameters				
纤芯包层直径/Fiber cladding Diameter	μm		220 / 242	
光纤数值孔径/Numerical Aperture	NA	0.21	0.22	0.23
光纤长度 ² /Fiber Length ²	m	1.5	2.0	
套管直径/Loose Tubing Diameter	mm	1.1	1.4	
套管长度/Loose Tubing length	m	1.2	1.5	
光纤接头/Fiber Connector			Bare Fiber/SC Ceramic Ferrule	
弯曲半径/Fiber Bend Radius	mm	65		

电学性能 ³ /Electrical Parameters ³				
光电转换效率/Conversion Efficiency	%		39	
阈值电流/Threshold Current	A		2.1	
工作电流 ³ /Operating Current ³	A			22.0
工作电压 ³ /Operating Voltage ³	V	62.7	64.7	66.7

热学性能 ³ /Thermal Parameters ³				
工作温度 ⁴ /Operating Temperature Range ⁴	°C	5		45
壳体温度 ^{1,4} /Package Temperature Range ^{1,4}	°C			45
盖板温度 ¹ /Lid Temperature Range ¹	°C			60
Boot温度 ¹ /Boot Temperature Range ¹	°C			45
存储温度/Storage Temperature Range	°C	-30		85
温漂系数/Wavelength Temperature Coefficient	nm/°C		0.35	
加电脚焊接温度/Lead Soldering Temperature	°C		400	420
加电脚焊接时间/Lead Soldering Time	s			5

机械尺寸图/Mechanical Dimensions Drawing



重量典型值/Typical value of weight < 1.9kg

¹ 在25摄氏度冷却板温度下测得。 Tested at 25°C cold plate temperature.

² 可根据客户需求定制。 Others available upon request.

³ 超规格使用会导致激光器寿命减少。 Reduced lifetime if used above nominal operating conditions.

⁴ 激光波长会随壳体工作温度变化产生漂移。 Laser Wavelength would shift when package operating temperature is changed.

※盖板采用柔性设计，有效减少壳体变形。使用过程中，发生响声属于正常现象，不影响产品的性能和可靠性。